

第47期 年次報告書

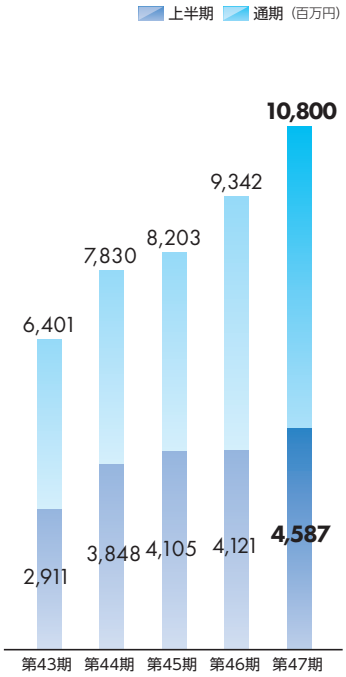
2025.08.01 ▶ 2026.07.31

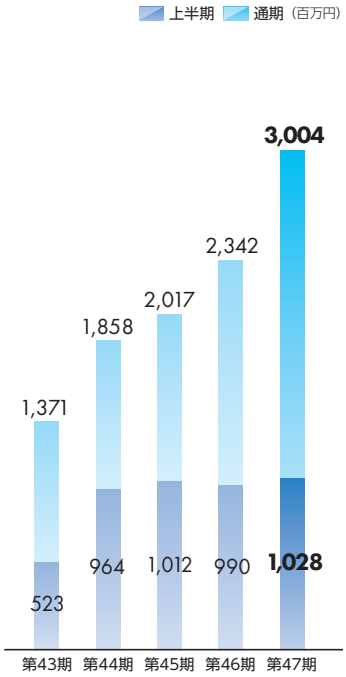
サムコ 株式会社

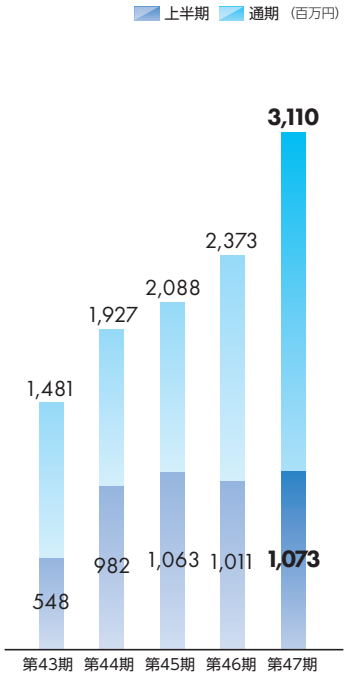
証券コード　6387

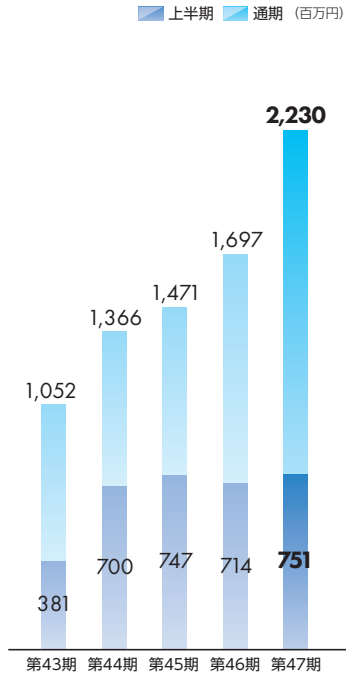
2026年７月期 決算ハイライト

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
10,800百万円	3,004百万円	3,110百万円	2,230百万円
前期比 15.6%増	前期比 28.2%増	前期比 31.0%増	前期比 31.4%増
期初計画比 5.9%増	期初計画比 22.1%増	期初計画比 27.5%増	期初計画比 29.7%増









2027年７月期 業績予想

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
14,500百万円	3,880百万円	3,840百万円	2,740百万円
前期比 34.3%増	前期比 29.1%増	前期比 23.5%増	前期比 22.8%増

株主の皆様へ

第47期の売上高・営業利益・当期純利益は過去最高となりました。最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
当社第47期（2025年8月1日～2026年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。



左：代表取締役会長
辻　理
右：代表取締役社長
川邊　史

第47期の事業環境、経営成績

当事業年度における世界経済は、中東情勢の緊迫化などによる影響がみられる一方、人工知能（AI）の進展とその普及を背景とした需要の拡大に支えられ、緩やかながらも成長が続いております。しかしながら、その恩恵はテクノロジー関連需要が経済を牽引する国・地域や、紛争の影響が比較的限定的なエネルギー輸出国などに偏っており、その他の国・地域では景気が低迷するなど、経済状況にはばらつきがみられます。

当社の属する半導体市場におきましては、生成AIの普及を背景としたデータセンター関連投資が引き続き活発に推移し、AI向けGPUなどの先端ロジック半導体や、GPUと組み合わせて使用される高速・大容量メモリーを中心に需要が拡大しました。半導体製造装置市場におきましても、先端ロジック半導体への設備投資に加え、メモリー向けの設備投資が拡大し、当初の想定を上回る市場成長が見込まれております。

また、AIデータセンターでは、処理能力の向上に伴いデータ通信量や消費電力が急速に増加しており、通信の高速化と低消費電力化を実現する技術として、光電融合技術への関心が高まっております。

このような環境のもと、当社におきましては、AIデータセンター向け光通信関連を中心に、化合物半導体分野における旺盛な設備投資需要を背景として、売上高は拡大いたしました。

その結果、当事業年度の国内売上高は4,346百万円（前期比24.5％減）となりました。一方、当事業年度の海外売上高は6,454百万円（前期比80.0％増）と大幅に増加いたしました。海外売上高比率は59.8％であり、中長期的に目標としている海外売上高比率50％を上回る結果となりました。

続いて、当事業年度の受注高は17,133百万円（前期比88.2％増）、当事業年度末の受注残高は11,457百万円（前期比123.6％増）となりました。装置受注から出荷までのリードタイムを短縮すべく、ＤＸを活用した受注予測に基づく見込み生産を始めとする生産体制の整備、見直しを進めております。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高10,800百万円（前期比15.6％増）、営業利益3,004百万円（前期比28.2％増）、経常利益3,110百万円（前期比31.0％増）、当期純利益2,230百万円（前期比31.4％増）となりました。

なお、期末配当金につきましては、経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、1株当たり75円00銭とさせていただきました。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

第47期定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、2026年10月27日開催の当社第47期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項

第47期(2025年8月1日から2026年7月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当として１株につき75円00銭と決定いたしました。

第２号議案　取締役９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として辻 理、川邊 史、山下 晴彦、宮本 省三、佐藤 清志、山本 仁志、高須 秀視、藤田 静雄、栁本 依子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高須 秀視、藤田 静雄、栁本 依子の各氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として羽津 隆弘氏が選任され、就任いたしました。なお、羽津 隆弘氏は社外監査役であります。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「第47期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において払渡し期間内（2026年10月28日から2026年11月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「第47期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以　上

特集 「中期経営計画」の2年目へ

当期（第47期）よりスタートした3ヵ年の中期経営計画を推進中であり、第47期につきましては各利益率・利益金額では当初の計画を上回る着地となりました。次期（第48期）では、売上高14,500百万円、当期純利益2,740百万円を目標に、全社を挙げて取り組んでまいります。今後の経済環境につきましては、中東情勢が一段と緊迫化する可能性に加え、サプライチェーンの混乱や貿易の分断化など、世界経済を下押しするリスクが引き続き存在しております。一方、AIデータセンターでは、処理能力の向上に伴いデータ通信量や消費電力が急速に増加しており、通信の高速化と低消費電力化を実現する技術として、光電融合技術への関心が高まっております。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。



トピックス

製品販売 AIデータセンター向け加工・成膜装置ラインナップを拡充

AIデータセンター需要の拡大を背景に、InPデバイス向け装置を拡充
・3・4・6インチ基板に対応するICP・CCP-RIE・PECVD等のラインナップを強化し、光通信・光電融合分野の幅広いプロセスに対応。
・研究開発装置で培った技術・実績を基盤に、量産・生産用途の需要取り込みを加速するとともに、GaAs・GaN高周波デバイス、GaN・SiCパワーデバイスへの展開を推進します。

①市場拡大
AIデータセンター投資の拡大により、光通信デバイス需要が増加
②対応領域拡大
3・4・6インチ対応×ICP・CCP-RIE・PECVD等のラインナップ拡充
③成長フェーズへ
研究開発用途での実績を基盤に、生産需要の取り込みを加速
光通信からGaAs・GaN高周波、GaN・SiCパワーデバイスへ展開



生産体制 生産能力拡大

当社はファブライト型生産を採用しており、製造・組立・電気配線などの工程は信頼できる外部協力会社へ委託しております。
今後の需要拡大を見据え、生産キャパシティを段階的に拡大しております。
組立：外部パートナーの活用により対応可能
調整・検査：能力増強を継続中
・中小型機：増強済み
・大中型機：増強に着手



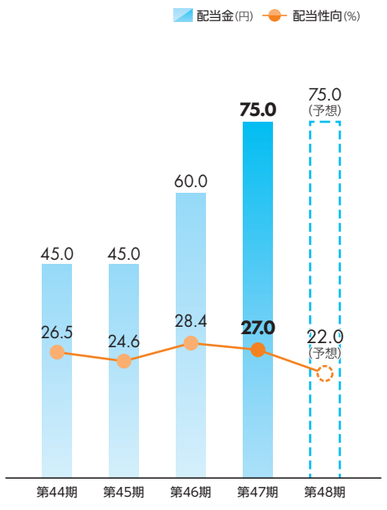
海外事業 国際学会・産学連携イベントで最新技術を発信

当社は、米国開催の「ALD/ALE 2026」および「OneNano Meeting」において、ALE（Atomic Layer Etching）技術に関する研究成果・技術講演を実施しました。
「ALD/ALE 2026」では、SiO_2準ALEプロセスのエッチングレート安定化に関する研究成果を発表しました。「OneNano Meeting」では、半導体材料向けプラズマエッチング技術に関する講演を行い、研究者・技術者との活発な技術交流を実施しました。両イベントを通じて、当社の先端エッチング技術の認知向上と、グローバルな研究機関・顧客との関係強化を推進しました。
今後も次世代半導体製造を支えるプロセス技術の研究開発と事業機会の創出に取り組んでまいります。





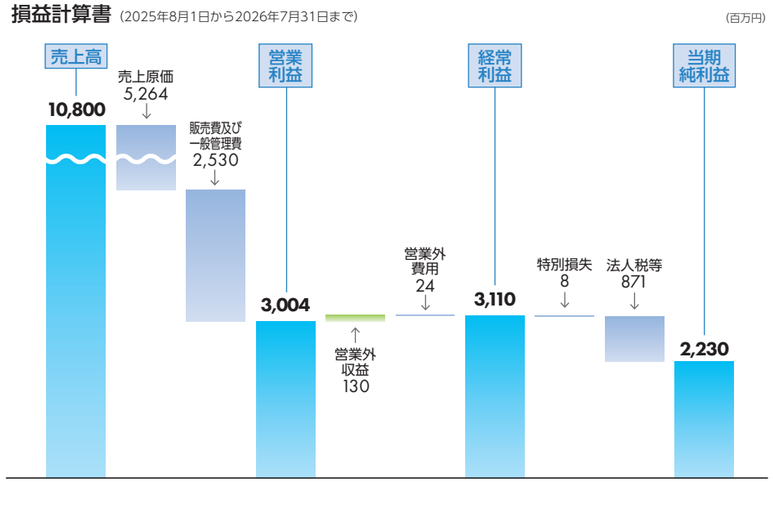
配当金・配当性向



財務諸表（要約）

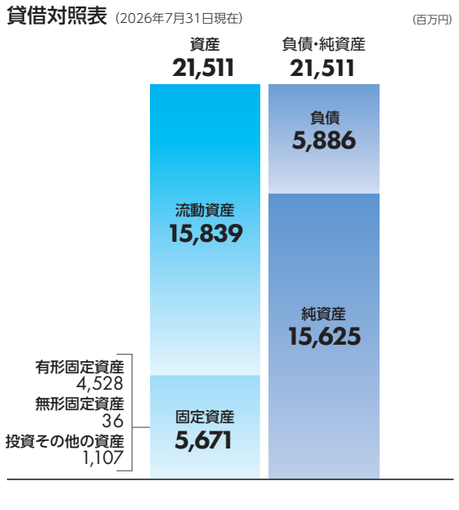
損益計算書 （2025年8月1日から2026年7月31日まで）

(百万円)



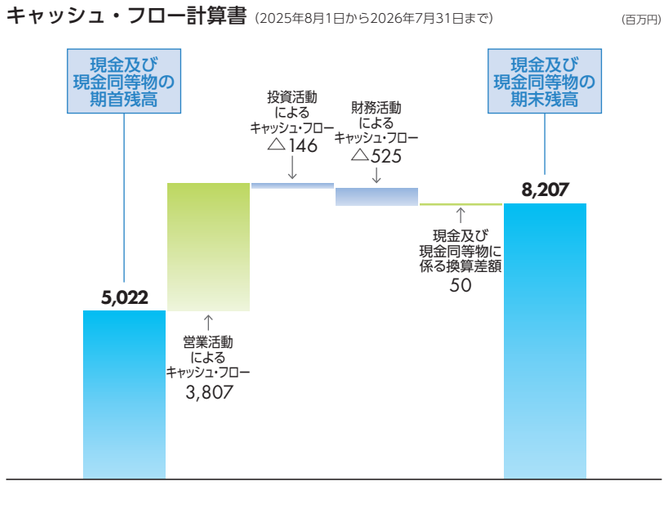
貸借対照表 （2026年7月31日現在）

(百万円)



キャッシュ・フロー計算書 （2025年8月1日から2026年7月31日まで）

(百万円)



サムコの事業内容

サムコ株式会社とは？



サムコは京都市伏見区に本社を置く**半導体等電子部品の製造装置を手掛けるメーカー**です。半導体や電子部品は皆様の快適な暮らしには欠かせないものとなり、当社では薄膜を形成するCVD装置・ALD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面をクリーニングする洗浄装置などの独自の製品を世界中に提供しています。

社名の**SAMCO（サムコ）**は、Semiconductor And Materials COmpanyの略で、半導体と材料開発の分野で躍進していくことを目指して名付けられています。

グローバルに事業を展開



1979年の創業以降、世界各国でグローバルに事業を展開し、現在はアジア、北米を中心に支店や子会社、販売代理店など、海外に11拠点を有しております。また、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供すべく、「直接販売」を行っており、京都から独自の製造装置を世界中に送り続け、これまで**世界36ヵ国に5,000台の装置を販売**してきました。

サムコが注力する化合物半導体とは？

当社は半導体の中でも**“化合物半導体”と呼ばれる材料に特化**した装置メーカーです。化合物半導体は、一般的な半導体デバイスで使用されているシリコン（珪素）とは異なり、複数の元素を組み合わせて作られる半導体で、高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っています。

主な化合物半導体の例



サムコはこれらの材料向けの製造装置を提供しています

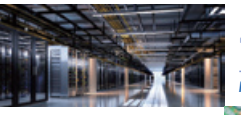


サムコの装置はどのような製品・技術に活かされている？

化合物半導体の加工や様々な電子部品の製造に、当社の装置が使われており、今後も市場の拡大が見込まれています。**当社の装置を使って製造されるデバイスや最終製品の事例**をご紹介いたします。

最先端技術で、未来の当たり前を創る

1. 光電融合・光デバイス
シリコンフォトニクス：CAGR 29.5%



2. 量子デバイス・2次元材料
量子コンピューター：CAGR 41.8%



3. 次世代パワーデバイス
パワーデバイス：CAGR 5.4%



4. 電子部品（高周波フィルタ・MEMS）
MEMS：CAGR 4.6%



5. 先端パッケージング
先端パッケージング：CAGR 9.4%



6. ライフサイエンス・ヘルスケア
ヘルスケア関連：CAGR 4.6%



出典：「IEA Energy and AI（2025）」、「MarketsandMarkets市場調査（2025）」、「Mordor Intelligence」

省エネ・脱炭素社会を支えるサムコの技術

化合物半導体が用いられるLEDや次世代パワーデバイスなどは、当社の**“薄膜技術”**が活かされた装置によって製造されており、**当社は省エネ・脱炭素社会を支えているメーカー**であると言えます。持続可能な社会の実現に向けて、サステナブルな企業価値創造を目指し事業を展開しております。



詳しくは当社ホームページ
https://www.samco.co.jp/sustainability/

TCFD TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

会社概要／株式情報

会社概要（2026年7月31日現在）

商号	サムコ株式会社（英文：SAMCO INC.）
設立	1979年（昭和54年）9月
事業内容	半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
資本金	1,663,687,288円
従業員数	201名
本社	〒612-8443　京都市伏見区竹田藁屋町36番地 TEL(075)621-7841　FAX(075)621-0936
国内拠点	本社（京都）、東日本営業部（東京）、 東海支店（愛知）、つくば営業所（茨城）
海外拠点	米国（カリフォルニア・ニュージャージー）、 台湾、シンガポール、中国（上海・北京）、マレーシア
研究拠点	本社研究開発センター（京都）、 オプトフィルムス研究所（米国）

株式の状況（2026年7月31日現在）

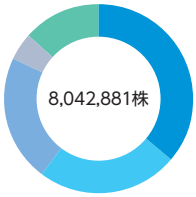
発行可能株式総数 ……… 14,400,000株
発行済株式の総数 ……… 8,042,881株
株主数 ……… 8,048名

大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
(一財)サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻　理	861,697	10.7
サムコエンジニアリング㈱	810,282	10.1
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)	646,900	8.0
㈱日本カストディ銀行(信託口)	274,200	3.4
辻　一美	201,465	2.5
野村信託銀行㈱(投信口)	153,400	1.9
㈱三菱UFJ銀行	129,600	1.6
野村證券㈱	124,746	1.6
MSIP CLIENT SECURITIES	124,580	1.5

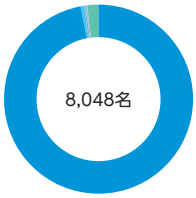
所有者別株式分布状況（2026年7月31日現在）

株式数



個人・その他	2,917,348株	(36.3%)
その他の法人	1,934,438株	(24.1%)
金融機関	1,736,400株	(21.6%)
金融商品取引業者	376,798株	(4.7%)
外国法人等	1,077,897株	(13.4%)

株主数



個人・その他	7,811名	(97.1%)
その他の法人	47名	(0.6%)
金融機関	19名	(0.2%)
金融商品取引業者	37名	(0.5%)
外国法人等	134名	(1.7%)

役員（2026年10月27日現在）

代表取締役会長	辻　理
代表取締役社長	川邊　史
取締役専務執行役員	山下　晴彦
取締役執行役員	宮本　省三
	佐藤　清志
	山本　仁志
社外取締役	高須　秀視
	藤田　静雄
	栁本　依子
常勤監査役	辻村　茂
社外監査役	木村　学
	羽津　隆弘
執行役員	松出　和男
	江﨑　裕二
	ヘンリー・チャン
	上杉　能章
	山本　潤
	八田　博文

株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日 上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
配当金支払株主確定日	期末配当金　7月31日 中間配当金　1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所プライム市場
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ（https://www.samco.co.jp/）に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502　大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部 電話　0120-094-777（通話料無料） ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ（https://www.tr.mufg.jp/daikou/）でも承っております。

（ご注意）
1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株主アンケート

皆様の声をお聞かせください

https://koekiku.jp

アクセスキー [redacted]

抽選でギフト券を進呈！

コエキク　サービス運営会社：株式会社プロネクサス　お問い合わせ：コエキク事務局　koekiku@pronexus.co.jp

ホームページのご紹介

https://www.samco.co.jp/



samco

FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C013080

VEGETABLE OIL INK

UD FONT